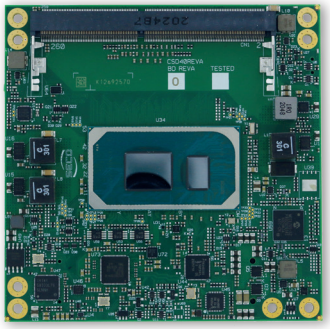
COM EXPRESS®

SOM-COMe-CT6-TGL-U

第11世代インテル® Core™ (旧称Tiger Lake UP3)プロセッサを搭載したCOM Express® Rel.第11世代Intel® コア™を搭載した3.0 Compact タイプ6モジュール (コードネーム:Tiger Lake UP3) プロセッサ

COM Express® コンパクト フォームファクタでの高性能で応答性の高いCPUとGPU コンピューティング



ハイライト

CPU
Intel® コア™ シリーズ (旧Tiger Lake UP3) プロセッサ

コネクティビティ
1x GbE;4x SuperSpeed USB 5Gbps; 8x USB 2.0;8x PCI-e x1 Gen3; PEG x4 Gen4

グラフィックス
統合されたIntel® Iris® Xeグラフィックス、最大96の実行ユニット

メモリ
DDR4-3200 IBECC メモリをサポートする2つのDDR4 SO-DIMM スロット、最大64GB

工業用温度範囲で使用可能

主な適用分野

メディカル / 交通機関 / 産業オートメーション / デジタルサイネージ

特徴

プロセッサ	**Intel® コア™ i7-1185G7E**、クアッドコア@ 2.8GHz (4.4GHzターボブースト)、12MBキャッシュ、28W TDP (12W cTDP)、Hyperthreading搭載 **Intel® コア™ i5-1145G7E**、クアッドコア@ 2.6GHz (4.1GHzターボブースト)、8MBキャッシュ、28W TDP (12W cTDP)、Hyperthreading搭載 **Intel® コア™ i3-1115G4E**、デュアルコア@ 3.0GHz (3.9GHzターボブースト)、6MBキャッシュ、28W TDP (12W cTDP)、Hyperthreading搭載 **Intel® コア™ i7-1185GRE**、クアッドコア@ 2.8GHz (4.4GHzターボブースト)、12MBキャッシュ、IBECC、28W TDP (12W cTDP)、Hyperthreading搭載 - 産業用 **Intel® コア™ i5-1145GRE**、は、クアッドコア@ 2.6GHz (4.1GHzターボブースト)、8MBキャッシュ、IBECC、28W TDP (12W cTDP)、Hyperthreading搭載 - 産業用 **Intel® コア™ i3-1115GRE**、デュアルコア@ 3.0GHz (3.9GHzターボブースト)、6MBキャッシュ、IBECC、28W TDP (12W cTDP)、Hyperthreading搭載 - 産業用
チップセット	統合Intel® PCH-LP
メモリ	DDR4-3200 メモリをサポートする2つの DDR4 SO-DIMM スロット、最大64GB インテル コア™ 産業用 SoC でのみサポートされる IBECC DDR4 メモリ モジュール®
グラフィック	Intel® Iris® Xeグラフィックス、最大96の実行ユニット 最大4つの独立したディスプレイに対応 DirectX 12、OpenGL 4.6、OpenCL 3.0、Vulkan 1.2をサポート ハードウェアアクセラレーション動画デコードAVC / H.264、HEVC / H.265、VP81、VP9、AV1 ハードウェアアクセラレーション動画エンコーディング AVC / H.264、HEVC / H.265、VP81、VP9

動画インターフェース	最大3つのデジタル ディスプレイ インターフェース (DDI)、DP 1.2、eDP 1.4、HDMI® 1.4、DVI をサポート eDP 1.4 x 1またはシングル/デュアルチャネル18ビット/24ビットLVDSインターフェース 1 x VGA インターフェース
動画解像度	eDP、DP: DSC で最大5120x3200 @60Hz 24bpp / 7680x4320 @60Hz 30bpp HDMI®: 最大4096x2160 @24Hz、24bpp LVDS : 最大1920x1200 @60Hz VGA: 最大2048 x 1536 @50Hz
質量ストレージ	S-ATA Gen3 チャネル x 2 2x PCI-e x4 ポートが M.2 NVMe ドライブに使用可能
ネットワーキング	ギガビットイーサネットインターフェース Intel® I225 GbE コントローラ
USB	SuperSpeed USB 5Gbpsホストポート ×4 USB 2.0ホストポート ×8
PCI-e	PCI-e x1 Gen3レーン x8 PCI-Express Graphics (PEG) x4 Gen4
オーディオ	HDオーディオインターフェース
シリアルポート	UART x 2
その他インターフェース	SPI、I2C、I2S、CAN、SMバス、温度管理、FAN管理 LPCバス オプションでTPM 2.0搭載可能 LID#/SLEEP#/PWRBTN#、Watchdog 4x GPI、4x GPO
電源供給	$+12V_{DC}$ ± 10%、$+5V_{SB}$ (オプション)、+3VRTC (オプション)
動作システム	Microsoft® Windows 10 Microsoft® Windows 10 IoT コア Linux

情報は変更されることがあります。このデータシートの最新版は www.edge.seco.com をご覧ください

SOM-COMe-CT6-TGL-U

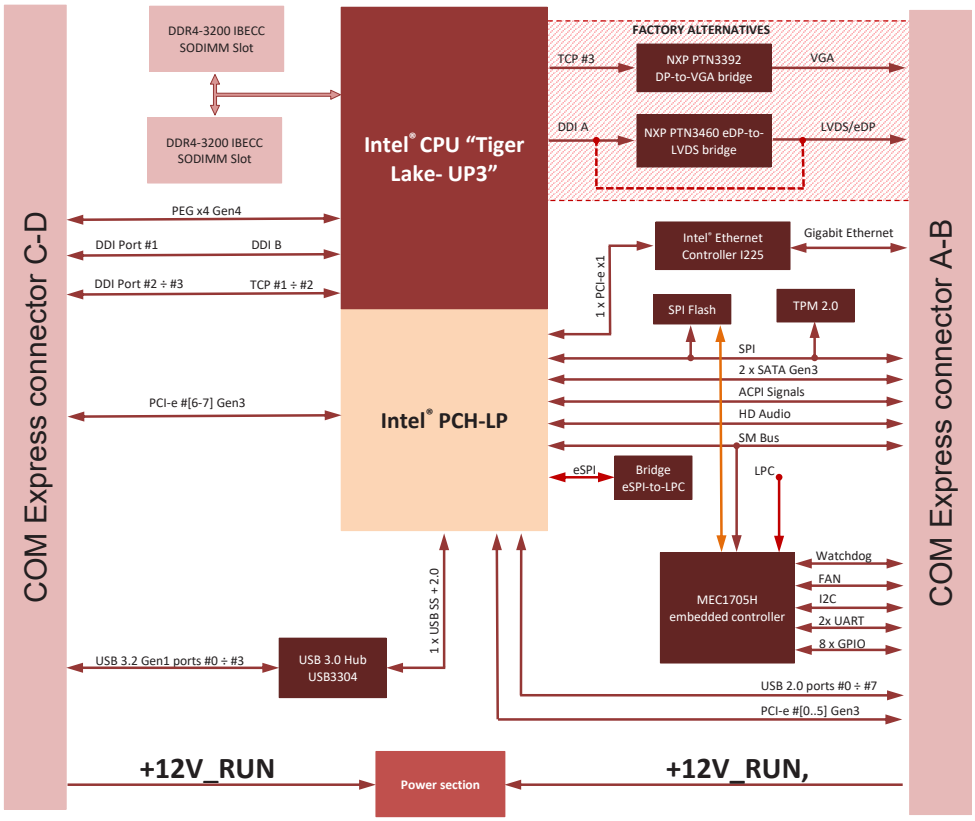
第11世代インテル® Core™ (旧称Tiger Lake UP3)プロセッサを搭載したCOM Express® Rel.第11世代Intel® コア™を搭載した3.0 Compact タイプ6モジュール (コードネーム:Tiger Lake UP3) プロセッサ

特徴

動作温度*	0℃ ÷ +60℃ (商用) -40℃ ÷ +85℃ (工業用)
寸法	95 x 95 mm (COM Express® Compactフォームファクタ、タイプ6 ピン配置)

*SECO規格の本製品用ヒートスプレッダーの任意の箇所で、常時 (起動時を含む) 測定。実際の温度は、用途、筐体、および/または環境に大きく依存します。ヒートスプレッダーの温度を指定された範囲内に保つために、最終的なシステムには用途に特化した冷却ソリューションを検討するようお客様にお願い致します。

ブロック図



情報は変更されることがあります。このデータシートの最新版は www.edge.seco.com をご覧ください
272.23

エッジコンピューティングの実装を合理化し、迅速化します

エッジホッグOS

カスタマイズツールとDockerのサポートにより、ニーズに適応する柔軟なオペレーティングシステムです。信頼性とセキュリティは、デュアルパーティションシステムとExeinの堅牢なAIベースの保護とのネイティブ統合によって組み込まれています。

デバイスマネージャー

更新、設定、またリモートデバイスを管理します。コストのかかる現場介入を必要とせずに、運用効率とセキュリティを最大化するために時間とコストを最適化します。

データオーケストレーション

サードパーティのサービスを統合し、データフローと分析を簡素化し、AI を簡単かつ迅速に利用できるようにするのでビジネス効率を高めます。

ポータル

リモートデバイスからのデータを分析し、ユーザーのニーズに合わせたアプリケーションでユーザーエクスペリエンスをカスタマイズし、ユーザー権限、企業アクセス、テナント権限を管理します。



スキャンして詳細を確認してください
ソリューション

エッジホッグOS

CLEA DOCS

情報は変更されることがあります。このデータシートの最新版は www.edge.seco.com をご覧ください